东方航空 打响航空混改第一枪

见习记者 张骞爻

日前,东方航空(600115)与达美航空签署了《股份认购协议》,达美航空拟斥资约34.89亿港元认购东方航空新发行的H股普通股4.6亿股,交易实施后,达美航空将持有东方航空约3%的股份,成为东方航空外部第一大股东。在以央企为代表的国企混改大潮中,东方航空此举无异于实质性的混改动作,或将成为央企寻求外部联盟的标准范例。

公开资料显示,达美航空系美国第三大航空公司,在全球拥有雇员近8万人,服务范围覆盖世界六大洲64个国家的351个目的地。此外,达美航空是全球最健康、盈利最好的航空公司之一,在航班准点率、避免航班取消、行李处理和客户服务等数据上排名表现突出。

据悉,东方航空与达美航空牵手绝非偶然。今年4月,达美航空首席执行官理查德·安德森曾公开表示,希望在与东方航空合作关系不断增进的基础上,在上海打造一个类似于阿姆斯特丹的国际枢纽。

另据了解,东方航空及达美航空目前以代码共享的方式,经营30条美国国内航线及43条中国国内航线。东方航空每日提供4班上海直飞美国三大城市的航班,达美航空每天提供6班美国直飞中国三大城市的航班。

达美航空似乎挑了一个大好时机投资东方航空。今年的东方航空财大气粗,得益于航油成本下调,今年上半年业绩大幅增长,预计实现净利润35亿~37亿,创上市以来中期最高盈利水平。另外,东方航空作为上海最大的基地航空公司,与迪士尼公司已建立合作关系。2016年迪士尼开园,东方航空业绩有望得到火箭式助推。

达美航空在一些关键领域,比如资产管理、国际合作和供应链都独树一帜。未来的东方航空有望引入达美先进的管理经验,东方航空的国际航线业务也将涉足蓬勃发展的中美航空市场。

集成电路封装产业链加速整合 大基金入股龙头

证券时报记者 阮润生

虽然标志全球半导体行业景气度的北美半导体设备BB值从2015年4月开始下降,但工信部公布数据显示,上半年国内电子信息制造业整体运行平稳,产业增加值高于工业平均水平。集成电路上市公司已披露的中期业绩预告显示,目前行业运行整体向好,特别是产业链中长电科技、通富微电、华天科技等封装测试龙头持续去年以来的稳定增长势头。

一位电子行业分析师对记者表示,今年集成电路产业格局将进一步分化形成定局,封装产业链兼并整合将持续发生,国家集成电路产业基金则会逐渐加大投资行业细分龙头。

封装整合将持续

目前,已有20余家集成电路上市公司公布中期业绩预告,八成公司业绩预增。封装产业链延续去年增势,上半年普遍预喜。

其中,长电科技上半年预增幅度最大。公司预计上半年归属上市公司股东的净利润将同比增加140%~170%,主要受益于半导体市场需求旺盛,高端产品净利润继续保持较快增长,另外公司封测产能利用率较高、盈利能力恢复。

通富微电预计上半年净利润同比增长50%至80%,最高有望实现净利润8894.7万元。对此,公司表示,主要是目前集成电路行业需求饱满,前次募投项目效益进一步释放,对当期业绩产生积极影响。7月该公司投资者调研报告显示,目前中高端产品占比进一步提升,计划每年50%的增长,2015年营收目标为28亿元。

另外,华天科技也表示随着募投项目实施,集成电路封装能力提高,预计上半年净利润增长20%至50%。紫光股份预计上半年归属于上市公司股东的净利润为8800万至1亿元,同比增长120%至150%。国民技术则预计上半年净利润同比增长456.62%至485.41%。上海贝岭、中颖电子预计业绩增幅最高将达80%。

去年,长电科技联手国家集成电路产业投资基金,斥资7.8亿美元竞购全球第四大半导体封装企业星科金朋,目前星科金朋控股股东已承诺接受本次要约,要约收购价格约为0.47新元/股。

上述电子行业分析师对记者表示,今年集成电路行业竞争格局将进一步分化,相比集成电路设计、制造,产业基础更成熟的封装产业链更加有望持续在海内外兼并整合,行业排在5名后公司被收购概率较大。而国家集成电路投资基金总经理丁文武近期也表示,大基金会支持封装业进一步兼并重组,做大做强。

数据统计显示,2014年国内排名前10的封装企业销售额总额为462.3亿元,占封装全行业收入仅接近四成,产业集中度尚待提高。

大基金投向细分龙头

去年9月设立的国家集成电路产业投资基金,从最初重点扶持制造龙头中芯国际,再到入股成为其大股东之一,目前大基金已经全面布局设计、封测、设备领域龙头,加大了对行业细分龙头艾派克等公司投资。招商证券行业分析师指出,国家大基金下一步将会重点投资半导体领域第二梯队核心公司和细分芯片龙头,并助力中国企业积极进行跨国并购。

艾派克5月公告大股东拟注入旗下经营耗材业务,并向大基金在内的对象定增募资7.5亿元,用于开发打印机芯片SoC。据介绍,该项目基于国家核高基32位CPU平台,利用公司国内唯一自主知识产权的PCRAM技术,开发并产业化喷墨打印机及激光打印机耗材新型SoC芯片等,项目建成后公司将形成新增年产芯片1亿颗的生产能力,主要用于喷墨打印机及激光打印机耗材、激光打印机等。

另外,三安光电于6月份公告,二股东三安集团将其持有的三安光电2.17亿股股份,作价48.39亿元转让给大基金,以推动III-V族化合物半导体为重点的集成电路业务进一步做大做强,未来有望整合制造和设计,成为化合物半导体龙头。

前述电子分析师也指出,大基金将围绕IDM(集成器件制造)模式,加大对先进制程投资。中芯国际和长电科技去年成立了合资公司,首次形成了国内集成电路设计公司在国内流片、中道封装和后段FC倒装的制造工艺,两公司已经获大基金投资。通富微电去年也与上海华虹宏力半导体、上海华力微电子在芯片设计、制造以及先进封装测试技术方面进行战略合作,实现一站式服务。

大众公用股东会通过发行H股议案 强化一体两翼战略

证券时报记者 姜云起

大众公用(600635)昨日召开临时股东大会,高票通过了公司赴港上市发行H股的议案。会上,公司董事长杨国平表示,赴港上市是为了公司业务发展的需要,短期虽然会摊薄每股收益,但未来一定会超过现在的水平。

根据大众公用本月13日披露的赴港上市方案,公司本次发行的H股股数不超过4.35亿股,约占发行后公司股份总数的15%,且公司授予联席全球协调人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售选择权。募集资金拟用于扩大营运规模、项目投资建设、收购兼并、偿还公司债和银行贷款、以及补充流动资金等。

同时,根据国务院相关规定,大众公用两名国有股股东上海燃气(集团)有限公司和无锡客运有限公司,将分别把不超过4354万股和132万股的股份划归全国社保基金。

杨国平表示,赴港上市主要是从公司发展角度考虑。首先,大众公用作为公用事业公司目标是立足上海走向全国,而境外市场上同样有一些优质的环保、暖气等企业,发行港股有利于公司更方便地实行收购兼并。

其次,公司实行的是"一体两翼"战略。"一体"指公用事业,"两翼"则是指股权投资与金融。目前公司是深圳市创新投资集团有限公司的重要股东之一,而深创投有些项目在香港和国内其他地区,发行H股对大众公用与深创投共同投资这些项目有所裨益。从深创投网站公布的数据来看,至今已有其投资的101家企业在境内外资本市场成功上市。

而对于发行H股后的公司业绩,杨国平也很有信心。他介绍,公司实业板块之一的大众交通,其出租车业务上半年虽然受到互联网冲击有一些影响,但多元化的战略使其他业务发展势头良好。例如租赁车业务承接了上海大部分国宾接待任务;物流方面在原有的城市配送和机场报关外,还将启动跨境电商业务。

另外,公司的污水处理业务主要包括嘉定污水处理工程和徐州污水处理工程。其中,嘉定污水处理三期工程已提前完成预定建设目标,目前公司正在为四期工程做准备,争取2017年启动。

天然气业务的销售情况也比较好。杨国平表示,上海已经完成了天然气管网改造任务,大众公用之前投资了30多亿元用于区域内天然气管网建设,为更好地提供天然气服务打下坚实基础。同时,公司占股50%的南通暖气其净资产收益率、每股税后利润在江苏省内也是名列前茅,经营质量不亚于南京中北旗下的南京暖气。

"总之,公用事业虽然没有暴利,但产业门槛比较高,具有垄断性,也不存在库存堆积和坏账等问题。公司将会稳健经营,如果此次H股发行成功将会给股东更好的回报。"杨国平说。